

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成26年3月20日(2014.3.20)

【公開番号】特開2012-159422(P2012-159422A)

【公開日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-033

【出願番号】特願2011-19937(P2011-19937)

【国際特許分類】

G 0 1 R 31/26 (2014.01)

H 0 1 R 33/76 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 31/26 J

H 0 1 R 33/76 Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 面と、該第 1 面に対向する第 2 面と、それぞれが該第 1 面と該第 2 面を連絡する複数の貫通孔と、を有する基板と、

それぞれの一部が前記複数の貫通孔のうちいずれかに挿入された複数の導電性コンタクトピンと、を備えた IC 用ソケットであって、

前記基板は、

前記第 1 面と、前記第 2 面と、前記複数の貫通孔と、を有する基材と、

前記複数の貫通孔と交差した状態で前記第 1 面及び前記第 2 面の間に設けられた、該基材よりも高い誘電率を有する少なくとも一つの誘電体層と、

前記基材の第 1 面から第 2 面に向かう方向に沿って、前記誘電体層を挟む第 1 及び第 2 導電層と、を備え、前記複数の導電性コンタクトピンは、

それぞれの一部が前記複数の貫通孔のうちいずれかに挿入され、該一部が前記第 1 導電層又は前記第 2 導電層に電氣的に接続された複数の第 1 導電性コンタクトピンと、

それぞれの一部が前記複数の貫通孔のうち、前記複数の第 1 導電性コンタクトピンが挿入された貫通孔以外の貫通孔のいずれかに挿入され、該一部が前記第 1 及び第 2 導電層に電氣的に接続されていない複数の第 2 導電性コンタクトピンと、を含み、

前記第 1 及び第 2 導電層の少なくともいずれかは、間に挿入される絶縁領域を介して水平方向に 2 以上の部分に分割されている、IC デバイス用ソケット。

【請求項 2】

前記絶縁領域は、その一方の面が前記基材の第 1 面に到達するまで伸びる一方、該一方の面と対向する他方の面が前記基材の第 2 面に到達するまで伸びた形状を有することを特徴とする請求項 1 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 3】

前記絶縁領域は、少なくとも一部が空気間隙であることを特徴とする請求項 2 記載の IC デバイス用ソケット。

【請求項 4】

前記複数の貫通孔のいずれかは、その内面に導体部材が設けられており、前記第 1 導電層

は、対応する導体部材を介して前記複数の第 1 導電性コンタクトピンのうち少なくともいずれかに電氣的に接続される一方、前記第 2 導電層は、対応する導体部材を介して前記複数の第 1 導電性コンタクトピンのうち、前記第 1 導電層が接続されたコンタクトピン以外のコンタクトピンのいずれかに電氣的に接続されている請求項 1 記載の I C デバイス用ソケット。

【請求項 5】

前記基板を支持するボディであって、検査すべき I C デバイスを前記基板上の所定位置に配置するためのガイド部と、前記 I C デバイスを検査する検査装置の所定位置に当該 I C デバイス用ソケットを配置させるための位置決め部と、を有するボディを、更に備えたことを特徴とする請求項 1 記載の I C デバイス用ソケット。